



决算说明书

1. “设备费”预算2万元，支出0万元，结余2万元。

2. “业务费”预算47万元，支出51.8886万元，超出4.8886万元，小幅超出预算。

“业务费”其中包含的“材料费”支出0.5509万元。用于项目执行过程中硅片、射频模块等材料的购买。

“业务费”其中包含的“测试化验加工费”支出41.3543万元。用于项目在半导体所集成技术中心进行器件的流片加工、测试等。

“业务费”其中包含的“燃料动力费”支出4.5万元。用于项目执行过程中，支付加工费用，水、电费。

“业务费”其中包含的“差旅/会议/国际合作与交流费”支出5.3936万元。用于项目组人员参加国际半导体技术大会、希腊第45届国际微米纳米工程会议等相关学术会议，国内外技术交流等。

“业务费”其中包含的“出版/文献/信息传播/知识产权事务费”支出0.0898万元。用于图书资料费、印刷费、通讯费等。

3. “劳务费”预算14万元，支出6.1390万元，结余7.8610万元。用于参与项目的博士、硕士、博士后、临时聘用人员等的劳务费用支出。

课题经费总结余4.9723万元，用于后续期间研究材料费、流片加工费用、测试费用、专利申请和论文版面费等支出，计划于结题一年内支出完成。